

PORTARIA INTERMINISTERIAL N.º 61, DE 12 DE MARÇO DE 2008

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no § 2.º do art. 4.º da Lei n.º 8.248, de 23 de outubro de 1991, no § 1.º do art. 2.º, e nos artigos 16 a 19 do Decreto n.º 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que consta no processo MDIC n.º 52000.000730/2003-65, de 13 de janeiro de 2003, Resolvem:

Art.1º O Processo Produtivo Básico para o produto TERMINAL DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE DÉBITO E CRÉDITO estabelecido pela Portaria Interministerial MDIC/MCT n.º 148, de 15 de agosto de 2007, passa a ser o seguinte:

I - montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;

II - montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e

III - integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final, montadas de acordo com os incisos I e II anteriores.

Parágrafo único. As atividades ou operações inerentes às etapas de produção acima descritas poderão ser realizadas por terceiros, desde que obedecido o Processo Produtivo Básico, exceto a etapa III, que não poderá ser objeto de terceirização.

Art. 2º Ficam temporariamente dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos:

I - leitor de cartão inteligente smart card;

II - leitor de código de barras;

III - dispositivo de cristal líquido ou de plasma;

IV - cabeça de impressão térmica; e

V - mecanismo impressor com capacidade de impressão máxima de até 6 (seis) cm de largura.

Art. 3º Fica dispensada a montagem da placa de circuito impresso destinada aos terminais de transações eletrônicas que implemente a função de criptografia dos dados e segurança, desde que o fabricante execute, internamente ou por terceiros, as etapas de injeção plástica das tampas superior e inferior do gabinete e a montagem da fonte de alimentação.

Parágrafo único. A fonte de alimentação de que trata este artigo deverá cumprir o processo produtivo básico descrito no caput do art 1.º desta Portaria e, adicionalmente, o transformador utilizado na fabricação da fonte de alimentação deverá ser fabricado a partir do bobinamento do carretel.

Art. 4 Ficam dispensadas, até 31 de dezembro de 2008, a montagem das placas de circuito impresso que implementem função de comunicação com tecnologia sem fio Wi-Fi, Bluetooth, WiMax, e outras tecnologias.

Art. 5 Fica dispensada, até 31 de dezembro de 2007, a montagem dos módulos de comunicação GSM (Global System for Mobile Communications), utilizados nos produtos de que trata o caput deste artigo, sendo que a partir de 1 de janeiro de 2008, o Processo Produtivo Básico deverá ser cumprido no percentual mínimo de 90% (noventa por cento), calculado com base na produção total, em quantidade, no ano calendário.

Parágrafo único. Caso o percentual acima não seja alcançado no período, no todo ou em parte, a empresa ficará obrigada a cumprir a diferença residual em relação ao percentual mínimo estabelecido, em unidades produzidas, no ano subsequente, sem prejuízo das obrigações correntes, nos anos-calendários respectivos.

Art. 6 Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, através de Portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia.

Art. 7 Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCT n. 148, de 15 de agosto de 2007.

Art. 8 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MIGUEL JORGE

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

SERGIO MACHADO REZENDE  
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia